



## 致股東報告書

各位股東、各位女士、先生大家好：

本人謹代表董事會及全體員工感謝諸位股東對本公司之支持與愛護。同時敬向諸位股東報告，本公司民國一一一年度經營成果及民國一一二年度經營計劃。

### 一、民國一一一年度營業報告

#### (一)民國一一一年度營業計劃實施成果

本公司一一一年度合併營業收入淨額為新台幣 11,897,939 千元，較一一〇年度 11,011,928 千元成長 8%；稅前淨利為新台幣 933,376 千元，較一一〇年度 512,508 千元增加 82%；稅後淨利為新台幣 613,158 千元及每股盈餘 7.1 元，與前一年度稅後淨利為新台幣 349,664 千元及每股盈餘 4.05 元相較，增加 75%。近年來受惠於個人電腦、遊戲娛樂、網路通信、伺服器、資料中心與高效能運算需求維持成長。因為性能不斷提升、運算效能與消耗功率增加，故帶動散熱裝置的質量及營收成長。近期因國際通貨膨脹情況未獲紓解，加上美元匯率與各國貨幣變動較大，也成了經營及獲利上的挑戰。

現今雲端(Cloud)、人工智慧(AI)以及 5G 等相關技術逐漸發展並臻成熟，散熱產品應用已自 PC 等個人裝置相關產業擴及至智慧型手機、雲端資料中心、互聯網、汽車、通訊、資訊運算設施及智慧家電等領域，整體散熱產品需求與市場規模皆持續加速成長。為提供更多元化的散傳熱品，本公司持續深耕既有客戶群，並積極開發車用散熱、雲端資料中心散熱、手持裝置散熱、遊戲機散熱、高瓦特數氣冷散熱以及液冷散熱以滿足市場需求。佈局 EV、AI、IoT 及 5G 等相關應用所帶動的產品發展為目標，全面提升全球重點區域/客戶之連結，以強化現有客戶的服務及新客戶之開發。

公司研發團隊除專注於成熟穩定之散熱產品使其更輕薄、性能更提升外，另包括電競筆電(Gaming NB)超頻散熱模組、運動攝影機(Action Camera)輕薄型熱板元件、高密度高運算性能(HPC)工作站級伺服器散熱模組，與自動輔導駕駛系統(ADAS)液冷板散熱方案，整合了氣冷/液冷系統和主動/被動散熱設計解決方案等開發。另，朝非 ~30~ 銅合金技術研發，目標運用於條件更嚴苛的車用與電力電子散熱方案，該需求散熱功率更高、強度需更強、重量更輕。面對近年來全球地緣政治安全變動風險提高、原物料價格波動劇烈、通貨膨脹持續升溫、以及 COVID-19 所造成全球產業鏈供需失衡與產品價格競爭等不利影響，本公司將持續致力於製程優化以提升產能與生產力，持續創新技術、產品與應用，以確保核心競爭力與綜合經營績效持續領先同業。

(二)預算執行情形：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司未公開民國一一一年度財務預測資訊，無需揭露一一一年度預算執行分析資料。

### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新台幣千元

項目		年度	110 年度	111 年度
財務收支	營業收入		11,011,928	11,897,939
	營業毛利		1,729,957	2,176,310
	稅後淨利		349,664	613,158
獲利能力	資產報酬率(%)		3.68	5.68
	權益報酬率(%)		7.70	12.23
	稅前淨利佔實收資本額比率(%)		59.35	108.10
	純益率(%)		3.17	5.15
	基本每股盈餘(元)		4.05	7.10

### (四)研究發展狀況

#### 1. 最近二年度研究發展支出

單位：新台幣千元

年 度	110 年度	111 年度
研究發展費用金額	506,726	574,543
佔當年度營收比率 (%)	4.60	4.60

#### 2. 研究發展成果

##### (1)開發成功之技術或產品

- (i) 智慧手機散熱產品--0.3mm 以下超薄均溫板開發完成。
- (ii) 高密度運算伺服器散熱產品--300 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iii) 網通設備散熱產品--600 瓦以上氣冷散熱模組開發完成。
- (iv) 車載 IGBT 散熱產品--2k 瓦以上液冷模組開發完成。

##### (2)進行開發之技術或產品

- (i) 持續 3S 輕/薄/強(Slight/Slim/Strong)散傳熱產品研發。
- (ii) AI 晶片散熱產品--100 W/cm<sup>2</sup> ~ 200W/cm<sup>2</sup> 高熱通量熱傳元件開發。
- (iii) 第三代半導體散熱產品--耐-40°C ~ 260°C 極高極低溫熱傳元件開發。
- (iv) 元宇宙穿戴式散熱產品--輕薄型非銅合金熱傳元件開發。

## 二、民國一一一年度營業計劃概要

### (一)經營方針

1. 積極開發新的產業及領域、新的合作客戶，並即時掌握契機以利擴大營收規模。
2. 整合研發部門，強化組織力，縮短產品開發週期。另設有專責研發中心，研發新型產品及技術，以厚實未來競爭之利基。
3. 充分利用 Nidec 集團資源，強化業務及產品開發、品質保證、採購等機能，不斷厚植競爭力。
4. 透過擴大越南工廠的生產和加速中國工廠的自動化、省人化等方式降低成本。
5. 臺灣工廠將專注于研發並產製新機種，量產機種逐步向海外轉移。

### (二)預計銷售數量及其依據

本公司主要銷售產品為熱管、熱板相關散熱模組及散熱片；主要產品線應用以個人電腦產業(PC)、伺服器(Server)、網路通信、智慧型手機及遊戲機等為主。本公司民國一二二年度除了穩固 PC、伺服器、網通及遊戲機等散熱零組件之現有市佔之外，將積極開拓既有產品線之潛在客戶、新產品應用領域之業務開發等。

### (三)重要之產銷政策

1. 生產方面：因為散熱產品的產業特性為標準件少、設變頻繁且下單急促，故本公司嚴格管理庫存及降低庫存量，並提高存貨週轉能力。此外，積極投入自動化生產設備，降低人力需求，並提升生產品質和製程簡化改善，設計共用性材料，以有效降低成本，進而提供更具競爭力的價格。
2. 銷售方面：除深耕既有國內外市場佔有率外，視市場供需情形，逐步增加熱板產能投資。另加強海外行銷佈局，建立代理銷售管道積極開拓國際市場。

## 三、未來公司發展策略

- (一)設定短、中長期之目標/願景，並全面展開行動計畫，積極追蹤執行成效並機動策略調整。
- (二)透過集團合作關係，擴大產品服務範圍與產業類別，取得各產品線在同業間之相對優勢位置。
- (三)持續提升研發技術質量與能量，與客戶共同分享研發成果與營收成長之績效。
- (四)持續提升高度的產能運用效率及自動化生產製程，以滿足未來市場需求。
- (五)關注 ESG(環境(E)、社會(S)、治理(G))永續報導等相關重要議題，並積極朝金管會頒佈之永續發展路徑及溫室氣體盤查與查證時程方向前進。持續注重產業之環保政策，節能、減少碳排放、營造友善環境與勞動條件等，善盡社會責任。

#### 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

公司面對外部市場競爭、證券主管機關頒布的新法令、國內外環保法令，以及全球經濟環境變化，在在影響公司營運績效及成果。本公司為因應整體經濟及全球化所帶來之外部環境變遷，除遵循證券主管機關法令規範外，並與上下游供應商及客戶良好溝通及合作，一起致力強化供應鏈整合，提升零組件自製率，改良生產製程以降低生產成本，並即時掌握客戶訂單需求做好原物料採購規劃，以不斷提升公司整體的競爭力。

最後 敬祝

身體健康 闔家平安

董事長：永井 淳一



執行長：永井 淳一



會計主管：陳美華

